



Förderung

Aiwanger: "Mit der Beteiligung an den beiden Pilotlinien stärken wir den Mikroelektronik-Standort Bayern nochmals massiv"

16. Dezember 2024

MÜNCHEN Mit vier sogenannten Pilotlinien baut die EU im Rahmen des European Chips Act die Infrastruktur für die Mikroelektronikforschung massiv aus. In Bayern sind vier Fraunhofer-Institute zentrale Partner für zwei der Pilotlinien zu den Themen „Advanced Packaging“ (APECS-Pilotlinie) und „Wide Band Gap“ (WBG-Pilotlinie). Das Bayerische Wirtschaftsministerium investiert hier mit Bund und EU rund 80 Millionen Euro. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger: "Kein modernes Industrieprodukt kommt heute mehr ohne fortschrittliche Mikrochips aus. Mit der Beteiligung an den beiden Pilotlinien stärken wir den Mikroelektronik-Standort Bayern nochmals massiv. Unternehmen in Bayern erhalten durch die Zusammenarbeit mit den Pilotlinien Zugang zu neuesten Chip-Technologien. Inhaltlich setzen wir dabei auf die Themen Chip-Design, Testen und Leistungselektronik – also auf Felder, auf denen Bayern, u.a. dank des Bayerischen Chip Design Centers, bereits herausragende Kompetenzen aufweist."

Die Förderung durch das Bayerische Wirtschaftsministerium mit über 13,3 Millionen Euro ist Voraussetzung dafür, dass über 66 Millionen Euro Bundes- und EU-Gelder nach Bayern fließen können. Insgesamt stehen in den acht beteiligten Bundesländern über 700 Millionen Euro EU-, Bundes- und Landesmittel für diese Investition in die Zukunft zur Verfügung.

Der Fokus der hauptsächlich in Deutschland angesiedelten Pilotlinie APECS (Advanced Packaging for Electronic Components and Systems) liegt auf der Integration verschiedener Technologiekomponenten (z.B. state-of-the-Art Chips und Sensoren). Das ist gerade für die deutsche Industrie besonders relevant. Beteiligt sind in Bayern das Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS in Erlangen, das Fraunhofer-Institut für Elektronische Mikrosysteme und Festkörper-Technologien EMFT in München und das Fraunhofer-Institut für Angewandte und Integrierte Sicherheit AISEC in Garching. Hier liegt der Schwerpunkt der Arbeiten der APECS-

Pilotlinie in den Bereichen Chip-Design, Analyse und Testen und dockt auch inhaltlich an das Bayerische Chip Design Center (BCDC) an.

Die WBG-Pilotlinie zielt auf die Entwicklung von Wide-Bandgap (WBG)- und Ultra-Wide-Bandgap (UWBG)-Halbleitern in den Feldern Leistungswandlung, Energieeffizienz, Automotive, Industrie und Healthcare. Das Fraunhofer-Institut für Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie IISB in Erlangen ist als einziges deutsches Institut auf Grund seiner herausragenden Expertise im Bereich Leistungshalbleiter an dieser Pilotlinie beteiligt.

Ansprechpartnerin:
Franziska Meinel
Stellv. Pressesprecherin

Pressemitteilung-Nr. 506/24